

国泰海通证券股份有限公司
关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，作为公司持续督导工作的保荐机构，负责京仪装备上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告：

一、 持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与京仪装备签署了持续督导相关的协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，京仪装备未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，京仪装备及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对京仪装备开展持续督导工作。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促京仪装备建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。

项目	工作内容
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导京仪装备及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了京仪装备治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，京仪装备有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了京仪装备内控制度建立与执行情况，京仪装备内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，京仪装备有效执行了相关内控制度。
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促京仪装备严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对京仪装备的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了积极配合，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对京仪装备的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了积极配合，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，京仪装备或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，京仪装备及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。

项目	工作内容
<p>15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，京仪装备未出现该等事项。</p>
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，京仪装备及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>保荐机构制定了对京仪装备的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，京仪装备未出现该等事项。</p>

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐机构开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、掌握核心技术，研发能力突出

公司作为国内实现进口替代的半导体专用设备供应商，高度重视核心技术的自主研发与创新，截至 2025 年 12 月 31 日，公司应用于主营业务的发明专利 130 项，研发创新成果显著。

在半导体专用温控设备的研发中，公司自主研发并掌握了制冷控制技术、精密控温技术、节能技术等核心技术，并结合温度控制算法，实现半导体前道工序环节温度的快速切换和精准控温。在半导体专用工艺废气处理设备的研发中，自主设计等离子（Plasma）发生器及控制单元、燃烧点火装置等核心工艺器件，掌握低温等离子废气处理技术、新型材料防腐及密封技术和系统设计算法等核心技术，实现国产半导体专用工艺废气处理设备的技术突破。在晶圆传片设备的研发中，公司自主研发并掌握了晶圆自动寻心装置技术、晶圆传控技术、晶圆翻片技术和微晶背接触传控技术等核心技术。目前，公司整体技术水平处于国内领先、国际先进水平。

2、定制化产品，满足客户多样化需求

公司的半导体专用温控设备型号现已涵盖逻辑芯片、存储芯片等领域的应用，对 28nm、14nm 逻辑芯片以及 128 层、192 层存储芯片领域均有良好的表现，温控范围从 -70℃ 到 120℃，空载温控精度为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ ，运行状态下温控精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温控范围、温控精度和冷却能力均处于世界先进水平，并领先于国内其他厂商，能够适配多种晶圆制造设备的定制化要求。

公司的半导体专用工艺废气处理设备有燃烧式、等离子式和电加热式，可处理氢气、硅烷气体、碳氟气体、三氟化氮、三氟化氯等全氟化物气体、易燃易爆性气体、酸性气体、有毒有害性气体。为适应不同晶圆制造客户的需求，公司的半导体专用工艺废气处理设备在处理容量、进气口数量以及燃料类型等方面又进

行了多机型扩展，满足了客户的不同需求。

晶圆传片设备的晶圆传控、翻片等功能是基于自主研发的底层特性，能够通过调整底层特性快速响应客户的定制化需求。

3、客户资源稳定

半导体制造行业技术工艺复杂且资本投入较大，对半导体设备的技术水平、可靠性和安全性有着严格的要求，因此对设备供应商的选择设置了严格的控制程序。经过持续努力的产业深耕，公司自主研发的半导体专用设备已成功进入多家行业知名半导体制造企业，与客户建立了良好的合作关系。公司根据上述企业的使用反馈情况，对客户在核心工艺需求和技术发展趋势等方面有着更深刻的理解，能够根据客户需求并基于现有的技术储备进行产品研发，快速响应客户定制化需求。因此，公司目前已拥有优质、稳定的客户资源，在行业内积累了良好的产品、技术和服务口碑，与主要客户有着稳定的合作关系。

4、客户服务与响应能力突出

随着半导体制造技术、设备的复杂化、精细化，半导体制造企业对于供应商产品的稳定性及服务、响应能力提出了更高的要求。公司产品质量可靠，可以稳定、持续的为客户提供高效服务。为更好的服务客户，增强客户对国产设备的信心，公司在主要客户所在地建立了本土化的服务团队，长期驻扎客户现场，跟踪公司产品运行情况，提高售后服务的响应速度和服务水平。同时，售后人员在客户现场可以更深入地了解公司产品的运行环境、客户需求及产品后续更新的需求，对客户提出的方案优化、技术调整等要求，提供快速响应的技术支持和客户售后维护，有利于公司产品的后续更新换代，以增强公司产品的竞争力。公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。

（二）经营风险

1、客户集中的风险

公司客户集中度较高，主要受客户所在下游行业集中度高的影响。如果公司主要客户生产经营情况恶化、资本性支出下降，导致其向公司下达的订单数量下

降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、市场竞争风险

全球半导体专用设备行业竞争激烈，市场主要被国际巨头企业所占据。目前，全球半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备及晶圆传片设备市场由少数国际厂商占据主导地位，公司在经营规模、市场地位等方面存在一定劣势。公司所处行业面临较强的竞争：市场地位方面，国外厂商具有较强的技术实力、市场份额，集成电路制造企业在采购设备时仍会考虑既有行业龙头企业的产品，存在一定粘性。经营规模方面，国外龙头企业成立时间较早，具备大规模生产经营的能力并实现了多业务协同、形成多条业务线，先发优势明显，而公司目前尚处于发展阶段，经营规模上存在一定劣势。产品应用方面，国外厂商在各类工艺环节及境外晶圆制造产线拥有较为丰富的应用经验，公司在部分工艺环节及境外晶圆制造产线的产品应用经验有待提升。同时，随着我国政策的大力支持，国内企业也逐渐加入到该行业中参与竞争。未来公司将面临着国际知名企业以及国内企业的竞争压力和市场竞争风险。如果公司产品技术水平及主要技术指标无法持续满足下游客户需求或者与竞品存在较大差距，公司将面临较大的市场竞争压力。如果公司不能在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力、持续满足下游市场对产品性能指标的要求，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位、经营业绩出现下滑。

（三）财务风险

1、毛利率波动风险

报告期，公司主营业务毛利率为 32.61%，如果未来公司无法进一步提升自身创新能力并保持技术实力的领先地位，或者行业竞争加剧导致产品价格下降，亦或者公司无法有效控制产品成本，都可能导致公司毛利率发生波动，给公司的经营带来一定风险。

2、应收账款坏账风险

随着公司营业收入规模的不断增长，公司应收账款规模整体呈现增长趋势。报告期期末，公司应收账款账面价值为 27,402.47 万元，占流动资产的比例为 6.41%。如果未来宏观经济形势下行或客户经营情况发生不利变化，公司可能面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

3、存货跌价风险

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司存货规模整体呈现增长趋势。报告期期末，公司存货账面价值为 239,471.88 万元，占流动资产的比例为 55.98%。公司半导体专用设备产品交付后，通常需要安装调试并运行一段时间后完成客户验收。报告期期末，公司发出商品账面价值为 153,998.84 万元，占期末存货账面价值的比例为 64.31%。如果未来产品销售价格发生重大不利变化或者市场需求发生变化导致产成品无法顺利实现销售，或发出商品无法顺利通过客户验收，公司可能面临存货跌价风险。

4、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司及子公司安徽京仪享受高新技术企业所得税税收优惠以及增值税即征即退税收优惠。若未来国家税收优惠政策发生不利变化，或公司及安徽京仪未能通过高新技术企业资格重新认定，将会导致公司承担的税负成本增加，进而对公司利润水平造成不利影响。

（四）行业风险

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，而半导体专用设备市场的发展主要受下游半导体制造市场推动，该类设备的需求会随着晶圆厂产线建设加快和设备投资支出的增长而增长。如果未来下游半导体的终端需求有所减弱，行业景气度下降，导致下游客户削减资本性支出，将会减少半导体设备行业的市场需求，从而对公司的持续发展产生不利影响。

（五）宏观环境风险

半导体技术的发展及广泛应用极大推动了科学技术进步和社会经济发展，成为国家重点支持的行业。近年来，国家相关部委出台了一系列鼓励和支持半导体行业发展的政策，为半导体及其专用设备制造行业发展提供了财政、税收、技术

和人才等多方面的有力支持。随着外部环境的变化，若未来公司所处行业国家政策或支持力度发生变化，公司不能及时调整以适应行业政策的变化，将会对公司的生产经营活动产生不利影响。

（六）其他重大风险

公司部分原材料采购自美国、日本等国家和地区的供应商或其境内代理商，如果供应商所在国出台相关贸易限制性政策，构建贸易壁垒，使得相关原材料出现价格上涨、供应短缺或供应中断的情况，公司将面临采购成本上升、供应链稳定性受到影响等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

随着国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，部分国家采用包括但不限于提高关税、限制进出口、列入“实体清单”等多种方式或者制裁措施实行贸易保护主义。上述境外制裁可能导致公司下游客户现有产线维护、新产线扩张、未来技术升级等受到不利影响，进而导致下游客户需求或者订单产生不利波动。客户产线建设进度放缓，可能导致公司相应订单交付计划有所调整、新签订单规模下降、产品验收周期拉长，进而影响公司采购和生产安排，导致公司业绩增速放缓，对公司财务状况和经营业绩带来一定的不利影响。客户先进制程产线建设进度和技术升级受阻，可能影响公司产品在先进制程产线的经验积累和技术更新，从而对公司业务发展产生一定的不利影响。

不排除因国际贸易摩擦、地缘政治矛盾的升级，国内半导体产业链上下游企业，包括集成电路制造企业、半导体产业设备、材料、零部件企业等，受到境外国家或境外组织采取限制措施，使得国内半导体产业发展面临境外制裁加剧的风险。该等境外制裁可能对公司生产经营带来不利影响。

四、重大违规事项

2025 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

本持续督导期间，公司主要会计数据情况如下：

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
营业收入	1,426,242,870.69	1,026,465,508.65	38.95	742,283,148.65
利润总额	159,197,818.34	167,767,317.65	-5.11	133,249,001.19
归属于上市公司股东的净利润	147,925,398.65	152,911,820.19	-3.26	119,135,490.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,211,757.12	115,752,020.73	-0.47	86,693,598.62
经营活动产生的现金流量净额	381,368,404.15	-293,160.98	不适用	41,089,427.79
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	2,201,507,799.63	2,074,268,676.11	6.13	1,933,688,598.41
总资产	4,784,099,725.00	4,044,557,850.71	18.28	2,860,771,455.34

本持续督导期间，公司主要财务指标情况如下：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同 期增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	0.88	0.91	-3.30	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.91	-3.30	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.69	0.69	-	0.67
加权平均净资产收益率（%）	6.92	7.63	减少 0.71 个百分 点	16.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.39	5.78	减少 0.39 个百分 点	12.15
研发投入占营业收入的比例（%）	9.81	9.17	增加 0.64 个百分 点	8.29

上述公司主要会计数据和财务指标分析如下：

2025 年营业收入 14.26 亿元，较上年同期增长 38.95%，主要系公司积极把握半导体产业市场需求持续增长所带来的市场机遇，积极开拓市场，扩大销售所致。

2025 年归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，较上年同期下降 3.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.15 亿元，较上年同期下降 0.47%，主要系公司始终高度重视核心技术的自主研发与创新，为提升技术竞争力，公司持续加大研发投入，导致研发费用较上年同期大幅增加。同时，本报告期确认的增值税即征即退税额同比减少，导致其他收益较上年同期大幅下降，导

致利润较上年同期小幅下降。

2025 年经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，从而导致本期经营活动现金流量净额较上期增长所致。

归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为 6.13%，总资产增加较期初增幅为 18.28%，总资产较期初增幅较大主要系本期销售需求增长导致存货大幅增加以及在建工程投入增加所致。

六、核心竞争力变化情况

（一）掌握核心技术，研发能力突出

公司作为国内实现进口替代的半导体专用设备供应商，高度重视核心技术的自主研发与创新，截至 2025 年 12 月 31 日，公司应用于主营业务的发明专利 130 项，研发创新成果显著。

在半导体专用温控设备的研发中，公司自主研发并掌握了制冷控制技术、精密控温技术、节能技术等核心技术，并结合温度控制算法，实现半导体前道工序环节温度的快速切换和精准控温。在半导体专用工艺废气处理设备的研发中，自主设计等离子（Plasma）发生器及控制单元、燃烧点火装置等核心工艺器件，掌握低温等离子废气处理技术、新型材料防腐及密封技术和系统设计算法等核心技术，实现国产半导体专用工艺废气处理设备的技术突破。在晶圆传片设备的研发中，公司自主研发并掌握了晶圆自动寻心装置技术、晶圆传控技术、晶圆翻片技术和微晶背接触传控技术等核心技术。目前，公司整体技术水平处于国内领先、国际先进水平。

（二）定制化产品，满足客户多样化需求

公司的半导体专用温控设备型号现已涵盖逻辑芯片、存储芯片等领域的应用，对 28nm、14nm 逻辑芯片以及 128 层、192 层存储芯片领域均有良好的表现，温控范围从-120℃到 120℃，空载温控精度为±0.05℃，运行状态下温控精度为±0.5℃，温控范围、温控精度和冷却能力均处于世界先进水平，并领先于国内其他厂商，能够适配多种晶圆制造设备的定制化要求。

公司的半导体专用工艺废气处理设备有燃烧式、等离子式和电加热式，可处理氢气、硅烷气体、碳氟气体、三氟化氮、三氟化氯等全氟化物气体、易燃易爆性气体、酸性气体、有毒有害性气体。为适应不同晶圆制造客户的需求，公司的半导体专用工艺废气处理设备在处理容量、进气口数量以及燃料类型等方面又进行了多机型扩展，满足了客户的不同需求。

晶圆传片设备的晶圆传控、翻片等功能是基于自主研发的底层特性，能够通过调整底层特性快速响应客户的定制化需求。

（三）客户资源稳定

半导体制造行业技术工艺复杂且资本投入较大，对半导体设备的技术水平、可靠性和安全性有着严格的要求，因此对设备供应商的选择设置了严格的控制程序。经过持续努力的产业深耕，公司自主研发的半导体专用设备已成功进入行业知名半导体制造企业，与客户建立了良好的合作关系。公司根据上述企业的使用反馈情况，对客户在核心工艺需求和技术发展趋势等方面有着更深刻的理解，能够根据客户需求并基于现有的技术储备进行产品研发，快速响应客户定制化需求。因此，公司目前已拥有优质、稳定的客户资源，在行业内积累了良好的产品、技术和服务口碑，与主要客户有着稳定的合作关系。

（四）客户服务与响应能力突出

随着半导体制造技术、设备的复杂化、精细化，半导体制造企业对于供应商产品的稳定性及服务、响应能力提出了更高的要求。公司产品质量可靠，可以稳定、持续的为客户提供高效服务。为更好的服务客户，增强客户对国产设备的信心，公司在主要客户所在地建立了本土化的服务团队，长期驻扎客户现场，跟踪公司产品运行情况，提高售后服务的响应速度和服务水平。同时，售后人员在客户现场可以更深入地了解公司产品的运行环境、客户需求及产品后续更新的需求，对客户提出的方案优化、技术调整等要求，提供快速响应的技术支持和客户售后维护，有利于公司产品的后续更新换代，以增强公司产品的竞争力。公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。

七、研发支出变化及研发进展（如有）

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	139,957,370.90	94,149,409.81	48.65
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	139,957,370.90	94,149,409.81	48.65
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.81	9.17	增加 0.64 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	

公司重视核心技术的研发，加大研发投入，本期研发投入较上年同期增长 48.65%，主要系研发人员职工薪酬及材料费大幅增加。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获专利 437 项，其中发明专利 130 项，专利数量持续增加。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第 110C000538 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为人民币 865,639,662.28 元，其中以前年度已使用金额为人民币 568,268,591.08 元，本年

度使用金额为人民币 297,371,071.20 元，募集资金余额为人民币 128,368,797.93 元，募集资金现金管理金额为人民币 301,000,000.00 元。

募集资金基本情况表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	1,341,900,000.00
减：直接支付发行费用	75,646,501.03
二、募集资金净额	1,266,253,498.97
减：	
以前年度已使用金额	568,268,591.08
本年度使用金额	297,371,071.20
现金管理金额	301,000,000.00
加：	
募集资金利息收入	28,754,961.24
三、报告期期末募集资金余额	128,368,797.93

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
招商银行股份有限公司北京长安街支行	110937577910601	4,899,839.30	使用中
中信银行股份有限公司北京枫丹壹号支行	8110701012402637669	103,000,603.68	使用中
中国农业银行博兴路支行	11221301040004769	-	已销户
交通银行北京台湖支行	110061520013006144041	20,468,354.95	使用中

公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律

法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，京仪集团持有公司 4,725.00 万股股份，占公司总股本的 28.13%，系公司的直接控股股东；北控集团持有京仪集团 100% 股权，通过京仪集团间接控制公司，系公司间接控股股东；北京市国资委直接持有北控集团 100% 的股权，通过北控集团、京仪集团间接持有公司 28.13% 的股份，是公司的实际控制人。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员直接及间接合计持有公司股份的情况以及报告期内持股变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
赵力行	副董事长	4,785,000	-1,595,000	集中竞价减持、询价转让
于浩	董事、总经理	2,118,750	-706,250	集中竞价减持、询价转让
卢小武	副总经理	487,500	-162,500	集中竞价减持、询价转让
周亮	副总经理、总工程师	157,500	-52,500	集中竞价减持、询价转让

注：赵力行、于浩、卢小武、周亮通过安徽北自间接持股。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本报告出具之日，京仪装备不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见

的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，系《国泰海通证券股份有限公司关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



姚 涛



黄 祥



2026 年 4 月 20 日